

# **IC Taiwan Grand Challenge**

## **競賽試行辦法**

**主辦單位：國家科學及技術委員會**

**共同主辦：工業技術研究院、台北市電腦商業同業公會、國際半導體產業協會**

2025/12/01 修正版

## 目錄

一、 關於 IC Taiwan Grand Challenge.....	1
二、 競賽領域 .....	2
三、 報名資格 .....	2
四、 競賽流程 .....	3
五、 評審組成與評分項目 .....	3
六、 獎勵內容 .....	4
七、 獲獎義務 .....	5
八、 其他注意事項 .....	5
九、 聯絡方式 .....	6
十、 附件.....	7

# IC Taiwan Grand Challenge

## 競賽試行辦法

### 一、 關於 IC Taiwan Grand Challenge

由台灣政府跨部會合力推動之晶創臺灣方案(Taiwan Chip-based Industrial Innovation Program，簡稱 Taiwan CbI)，為善用台灣半導體高科技產業鏈優勢，以晶片結合生成式 AI 等關鍵技術，並以「結合生成式 AI+晶片帶動全產業創新」、「強化國內培育環境吸納全球研發人才」、「加速異質整合及先進技術」、「利用矽島實力吸引國際新創與投資來臺」等四大布局，帶動全產業發展。

為即早發掘潛力團隊、建立與台灣之鏈結，IC Taiwan Grand Challenge 於 2024 年首度舉辦，吸引的全球 IC 相關新創及學研人才，透過競賽擇優篩選來台設立據點、鏈結國際與民間資金擴散晶片新創應用，以全球最完整的半導體產業生態、快速支援創意實踐。

台灣政府也期盼藉此獎項，整合在地 IC 設計、製造、封裝測試到產品流程，以跨國際、跨產學研的徵獎規模，將全球具創新潛力的未來之星匯聚在台，讓人才有發揮空間並實質落地、帶動商機同時驅動相關產業發展。

## 二、 競賽領域

運用 AI 晶片、AI 演算法、高速傳輸等開發以下類別的先進應用解決方案，或就核心技術進行突破創新：

- AI Core Technologies and Chips（如 AI 晶片設計、AI 系統、硬體加速技術、生成式應用、大語言模型、資安等）
- Smart Mobility（如電動車、自動駕駛、智慧城市、通訊產業、無人機）
- Smart Manufacturing（如智慧製造、IC 製程、機器人）
- Smart Medtech（如生物辨識、智慧監測、智慧醫療）
- Sustainability（如永續製造、節能創新、新能源）

## 三、 報名資格

（一） 規劃攜手台灣半導體晶片設計、製造產業，共同合作發展創新應用之新創、法人及學研機構、自然人，並符合下列資格均可提出：

1. 以公司身分參賽者，須為以報名日起算 8 年內成立的新創，但非公司性質法人、學研機構、自然人不在此限。
2. 不得為大陸地區（含港澳地區）之新創、人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司。
3. 前項所稱第三地區投資之公司，指大陸地區（含港澳地區）人民、法人、團體或其他機構對於第三地區之公司有下列情形之一者：
  - 直接或間接持有該第三地區公司股份或出資總額逾百分之三十。
  - 對該第三地區公司具有控制能力。

（二） 參賽單位須擁有該產品、技術或解決方案之智慧財產權或已取得合法授權使用。

（三） 參賽單位須於指定時間內提供構想書(初審)及進行簡報(複審)，構想書內容包括技術核心、目前已解決或獲得驗證情形、欲發展之商業

模式、市場拓展規劃，並提交 3 分鐘以內的 Pitch Video 等。

- (四) 曾於 IC Taiwan Grand Challenge 競賽獲獎之參賽者，於本次競賽中將不予核發獎勵，但法人或學研機構之計畫主持人如與先前參賽時不同，則不在此限。

#### 四、 競賽流程

本獎項徵選為線上競賽，同一參賽者可不限次數參與，說明如下：

- (一) 第四梯次自 2025/12/19 至 2026/3/19 截止。2026/3/20 開放參賽者補齊申請資料。實際截止期間以活動網站 [ictaiwanchallenge.org](http://ictaiwanchallenge.org) 公告為主，主辦單位保留修改之權利。
- (二) 線上報名：有意參賽者可隨時至線上報名網址：[ictaiwanchallenge.org](http://ictaiwanchallenge.org) 填寫報名資料並上傳所需提交之資料。
- (三) 資格審查：由主辦單位依據辦法進行資格審查及確認競賽類別。
- (四) 初審：構想書內容審查，依審查結果另行通知是否進入複審。通過初審之參賽者需提交 IC 新創落地輔導資源需求表(附件)及公司股東持股比例。
- (五) 複審：以線上進行報告與問題詢答，簡報者需具備流利英文聽說能力，全程以英文呈現(含簡報及答詢)，時間共計 20 分鐘。
- (六) 結果公告：主辦單位將依據需審查案件量安排審查時間，並於審查結束後兩週於競賽網站及國科會官網公布結果。

#### 五、 評審組成與評分項目

- (一) 評審組成：邀請台灣產業、創投、政府部門等領域專家組成委員會，經由初審、複審階段選出獲獎者。
- (二) 評分項目：

評選標準	說明	評分 佔比
在地連結性	1. 具有來台資源需求及具體發展規劃 2. 能為台灣產業提供更寬廣的發展空間	40%
價值創造性	1. 能帶動科技創新潛力，創造社會福祉 2. 促成新產業鏈結或促進產業升級之貢獻 3. 引進衍生投資或創造高度經濟價值之成效	40%
技術創新性	1. 於新興應用領域之創新性 2. 在製程、設計、新材料運用範疇具開創性 3. 能融入多元創新與整合跨域思維優勢	20%

## 六、 獎勵內容：

- (一) 給予落地獎金美金3萬元/隊：獲獎者須於投資協議書合約簽訂前，至少1人在臺進行合計至少1個月產業媒合，將按照獲獎者需求量身客製規劃，並於獲獎者在臺報到後給予獎金。若遇不可抗力因素致使團隊無法配合主辦單位之安排與活動，得與主辦單位協調出合適之撥款條件。
- (二) 獲獎新創團隊來臺落地後，由本計畫專責輔導團隊依其在臺研發與營運之實際需求，協助與國內半導體產業鏈進行媒合，包含 EDA 工具、矽智財授權服務、IC 專業設計服務及晶圓共乘 Shuttle 等晶片開發所需之資源，協助加速其在臺晶片或產品之開發與落地。
- (三) 產業專家審查及業師輔導：將由台灣半導體產業資深技術專家、創投等籌組審議會，審查獲獎者所提平台資源需求，並視需求安排業師對獲獎者提供專業輔導諮詢。
- (四) 其他落地資源：取得台灣科技新創基地 TTA 空間進駐資格，（台北小巨蛋及南部據點，<https://www.taiwanarena.tech/>）及相關商務開發輔導。專職輔導經理擔任獲獎者與顧問/業師間輔導橋樑，協助獲獎者串接所需資源。

## 七、 獲獎義務

- (一) 參賽者通過初審後需提交 IC 新創落地輔導資源需求表(附件)，確認獲獎後，國科會將依申請內容與實際需求責請輔導團隊提供獲獎新創團隊在臺產品開發與落地所需之協助。
- (二) 獲獎者須配合來台進行實體商務鏈結發展，參與指定展會進行展示、技術發表、頒獎等活動--2026/6/2-5 COMPUTEX/InnoVEX。
- (三) 獲獎者需協助廣宣活動提交相關資料或參與宣傳，並配合主辦單位安排之在台對接行程活動及管考審查等事項。

#### 八、 其他注意事項

- (一) 參賽標的內容嚴禁抄襲、翻譯、改寫、侵害智慧財產權等違法侵權之情形。
- (二) 參賽者須保證所有填寫或提出之資料均屬事實且正確，且不可冒用任何第三人之資料。
- (三) 參賽者應尊重評審委員會決定，除能具體證明其他參賽者違反本辦法相關規定，對評審結果不得有其他異議。
- (四) 參賽者應同意主辦單位基於參賽者管理、報名管理、活動期間身分確認、活動聯繫、競賽活動相關訊息聯繫及相關行政作業之目的，得蒐集處理參賽者之個人資料。
- (五) 根據中華民國所得稅法，本競賽之獎金須依稅法相關規定預扣繳所得稅(本國人 10%、非本國人 20%)。獲獎者應提供其身分證明相關文件，供主辦單位報稅使用。
- (六) 參賽者同意將產品技術訊息授權予主辦單位(或主辦單位指定之第三人)基於非營利宣傳目的進行出版、著作、公開展示、及發行各類型態媒體宣傳使用。參賽者並有配合簽署相關授權文件之義務。
- (七) 凡報名參加此競賽者，即視為已充分瞭解本試行辦法中各條款，且願意完全遵守各項規定，如有違反本試行辦法者，主辦單位得取消其參賽及獲獎資格並要求其賠償主辦單位一切損失(包括但不限於

訴訟費、律師費、對第三人之賠償)，已獲獎者應繳回已受領獎勵或獎勵之價額。

- (八) 主辦單位保留修改本試行辦法之權利，將滾動修正並即時公布，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理。

## 九、 聯絡方式

競賽執行：台北市電腦商業同業公會 Jacky Chen

聯絡電話: +886 2 25774249 Ext. 940

Email： [jacky\\_chen@mail.tca.org.tw](mailto:jacky_chen@mail.tca.org.tw)



## 附件：IC 新創落地輔導資源需求表

辦法說明：

藉助臺灣在半導體領先的實力與豐沛的資源，彙整晶片開發所需之關鍵資源，協助全球 IC 新創在台落地實現潛力產品。

詳細需求說明：(請詳細說明產品與需求細節，包括產品規格、製程節點、台灣廠商合作內容等)

☐ 產品名稱與功能方塊圖(Block diagram)：

☐ 產品規格：(請條列細節)

產品開發之資源需求：(可複選並說明)

☐ EDA tool 需求：\_\_\_\_\_

☐ IP 需求：\_\_\_\_\_

☐ IC 設計服務需求：\_\_\_\_\_

☐ 規劃投片晶圓廠：\_\_\_\_\_

☐ 製程節點：\_\_\_\_\_ nm

☐ 製程類型 type (GP, BCD, RF, Mixed-Signal...etc.)：\_\_\_\_\_

☐ 封測需求：\_\_\_\_\_

☐ 系統整合需求：\_\_\_\_\_

☐ 設備製造商：

☐ 產品開發之時程規劃：

☐ 已接洽過之臺灣廠商：

其他需求說明：(可複選並說明)

- ☐ 商務發展需求：\_\_\_\_\_
- ☐ 募資需求：\_\_\_\_\_
- ☐ 在台設立公司：\_\_\_\_\_
- ☐ 其他（可條列說明，如產品開發需求之額外補充....等）：\_\_\_\_\_

### 股權資料內容

#### 股權結構：

股東名稱	國籍	持股比例

簽名同意(公司以負責人或 CEO 簽署；未成立公司之團隊則需所有團隊成員簽署)：\_\_\_\_\_